

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2021 年 11 月 19 日投资者关系活动记录表

编号：2021-11-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称 及人员姓名	永赢基金管理有限公司：常远、蔡霖、乔敏、晏青、范帆、任桀、张海 啸、李琦 广发证券：翟凌阳 上海胤胜资产管理有限公司：王道斌
时间	14：20~15:40
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	副总经理、董事会秘书：蒋威 证券事务代表：王渝
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;">一、公司历史介绍</p> <p>公司成立于 1993 年，持续 28 年深耕线路板产业链，从 PCB 样板起家，2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2015 年通过收购美国 HARBOR 和设立上海泽丰（现已出表）进入半导体测试板，公司坚持走技术升级道路，以研发促进产品、技术和应用领域的升级，实现了从传统 PCB 到半导体测试板、IC 封装基板的产品、技术和客户升级。同时，产品结构、经营模式的差异使得公司具备一定的议价能力，毛利率处于同行较高水平。受益于早年的布局，当前 IC 封装基板全球缺货及下游爆发式增长给</p>

公司带来了良好的发展机遇，未来公司的重点工作是推动广州兴科项目 IC 封装基板业务的投资扩产。

二、产能情况介绍

PCB 业务：2020 年度，广州生产基地产能为 33.72 万平方米/年；宜兴生产基地产能为 25.5 万平方米/年；英国 Exception 公司产能为 0.4 万平方米/年；广州生产基地新增中、高端、多层样板产线，规划产能为 1.5 万平方米/月，目前产能处于逐步释放过程中；小批量产线在广州生产基地和宜兴生产基地，此次公司启动的非公开发行项目主要是宜兴生产基地二期工程，建设完成后将新增 96 万平方米/年的量产产能，将分期建设投产。

半导体测试板：经营模式与样板类似，属于多品种、小批量、定制化生产，产品单价和附加值较高。主要主体有美国 HARBOR、广州科技及上海泽丰。HRABOR 从事测试板的设计、生产和贴装，虽然产能少，但单价高。广州科技测试板扩产目标是建设国内最大的专业化测试板工厂，并为美国 Harbor 提供产能支持。上海泽丰专注于半导体测试板的设计业务，公司于 2020 年上半年转让部分上海泽丰股权之后，不再控股及并表。

2021 年上半年半导体测试板实现销售收入 2.03 亿元；2021 年上半年测试板收入同比下滑主要是因为出售上海泽丰股权导致其不再纳入合并报表，美国 Harbor 产能受限，以及国内扩产的半导体测试板产能尚未形成增量贡献。

IC 封装基板：目前广州生产基地 2 万平方米/月的产能已处于满产状态，良率保持在 95%以上；与大基金合作的 IC 封装基板项目（广州兴科）分二期投资，第一期规划的产能为 4.5 万平方米/月，目前已在珠海完成厂房建设，处于装修和产线安装调试阶段。

三、IC 封装基板业务介绍

半导体行业从去年开始表现出产销两旺的格局，收入、利润持续增长，产业链高景气。IC 封装基板和半导体测试板是芯片制造和测试的关键材料，受益于芯片产业链的高景气，目前订单能见度高。

2020 年全球 IC 封装基板行业规模 100 亿美金、增长 25%，Prismark

预测 2021 年全球 IC 封装基板行业规模达到 120 亿美金，增长接近 20%，2025 年达到 160~170 亿元、复合增长率 9.7%，届时 IC 封装基板将超过软板成为线路板行业中规模最大、增长最确定的细分子行业。目前内资载板厂 2020 年规模 4 亿元美金，全球市场占有率仅有 4%，而国内封测厂全球市场占有率 25%以上，国产配套率仅有 10%左右。未来国内晶圆和封测产能持续扩产是 IC 封装基板行业需求增长的保证。公司 2012 年开始进入 IC 封装基板领域，2019 年实现财务层面盈利，预计 2021 年实现经营目标。

IC 封装基板目前国内仅有三家公司具备量产能力和稳定的客户资源，我们就是其中一家，行业赛道好，玩家少。三星认证的通过说明了我们的体系、能力、技术都得到了头部客户的认可，且海外大客户的认证周期都是长达 2 年以上，因此预计未来 2~3 年新进入者还无法成长到与公司抗衡，产业链供需格局还是很好。

四、宏观经济因素波动对半导体行业的影响

公司营收规模由 2010 年的 8.04 亿元稳步增长至 2020 年的 40.35 亿元，十年复合增长率为 17.51%，从历史上看，受宏观经济波动影响较小。同时，公司获取订单能力较强，不依赖单一客户，客户群体所涉行业较广，也一定程度上能抵抗宏观经济因素波动带来的影响。

五、对未来行业判断

总体是乐观的，但也存在一些不可控因素，如疫情、中美贸易战、缺货、原材料涨价等，均会对行业产业链造成一定的冲击。目前国内疫情所带来的影响正逐步减弱，带动需求回升、订单增长。企业未来的增长空间视产品结构及客户结构而有所不同，随着公司逐渐扩大高端产品占比，及多行业优质客户的深度绑定，未来增长空间可期，只要继续保持研发和技术上领先，良率和交付持续改善，随着产能的持续增长，公司有望实现持续稳定发展。

附件清单	无
日期	11 月 19 日